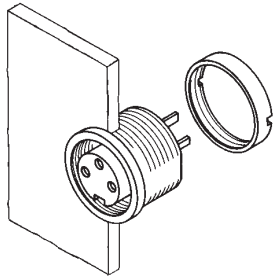
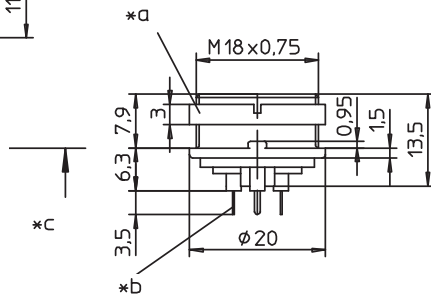
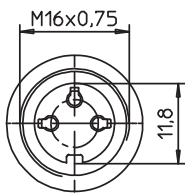
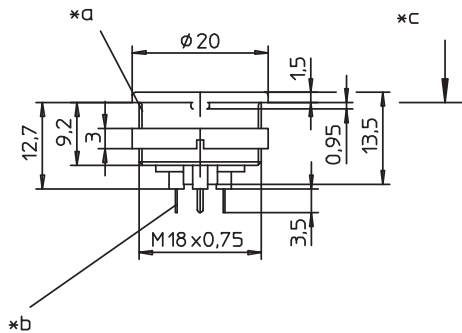
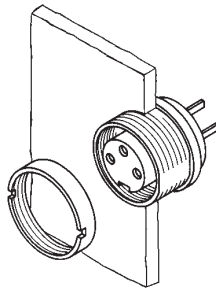




KFR

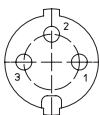


KGR

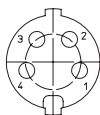


Leiterplattenlayouts siehe Seite 3.63
 Printed circuit board layouts see page 3.63
 Modèles des cartes imprimées voir à la page 3.63

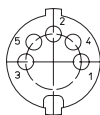
Polbilder, von der Lötseite gesehen
 Pin configurations, solder side view
 Schémas de raccordement, vus du côté à souder



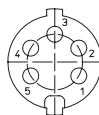
KFR 30
KGR 30



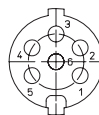
KFR 40
KGR 40



KFR 50
KGR 50



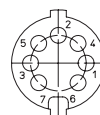
KFR 50/6
KGR 50/6



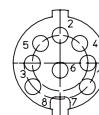
KFR 60
KGR 60



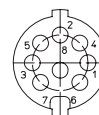
KFR 70
KGR 70



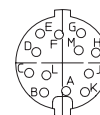
KFR 71
KGR 71



KFR 80
KGR 80



KFR 81
KGR 81



KFR 120
KGR 120

KFR KGR

Einbaukupplung nach IEC 60130-9, IP 40, mit Schraubverschluss, für Leiterplatten

KFR: für Frontmontage

KGR: für Rückseitenmontage

1. Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

2. Werkstoffe

Kontaktträger
 Kontaktbuchse 3- bis 8-polig

Kontaktbuchse 12-polig

Gehäuse
 Ringmutter

PA GF

CuZn, versilbert und flashvergoldet,
 im Lötbereich verzinkt

CuZn, unternickelt und vergoldet,
 im Lötbereich verzinkt

Zn-Druckguss, vernickelt

CuZn, vernickelt

3. Mechanische Daten

Steckkraft/Kontakt 3- bis 8-polig¹

< 5,0 N

Steckkraft/Kontakt 12-polig²

< 5,0 N

Ziehkraft/Kontakt 3- bis 8-polig¹

> 1,2 N

Ziehkraft/Kontakt 12-polig²

> 0,9 N

Kontaktierung mit

Schutzart³

Steckern 033098, 033099, SV, WSV
 IP 40

4. Elektrische Daten

Durchgangswiderstand

≤ 5 mΩ

Weiteres siehe Tabelle

¹ gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,5 mm

² gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,0 mm

³ nach DIN EN 60529,

⁴ nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück

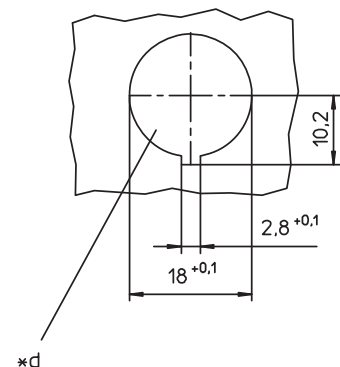
nach VDE 0110/IEC 60664

*a Mutter lose beigelegt
 nut enclosed separately
 écrou ajouté séparément

*b für Leiterplattenbohrung
 for bore hole of printed circuit board
 pour perçage de la carte imprimée
 Ø 1,0 mm (KFR 30-81)
 Ø 0,7 mm (KFR 120)

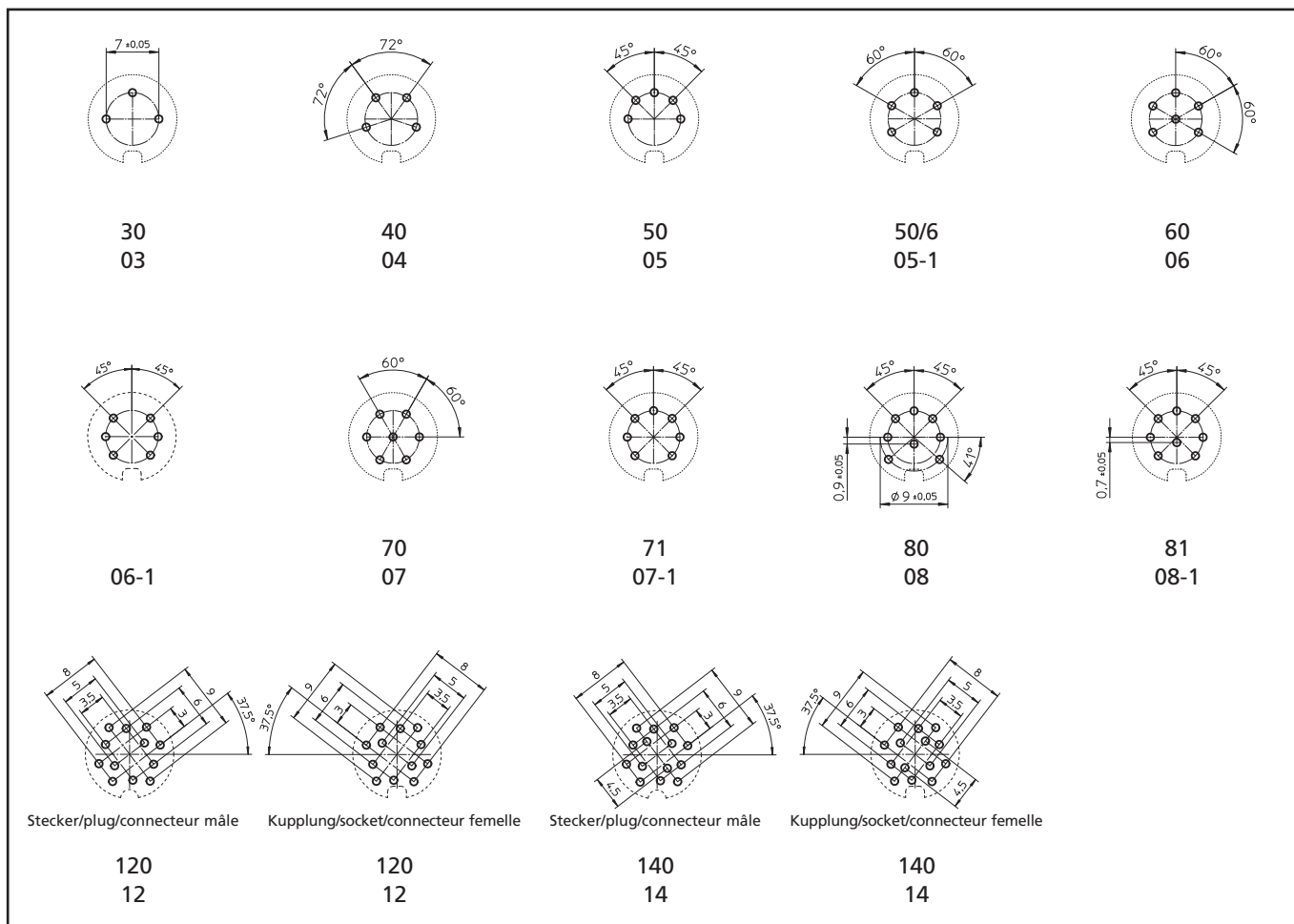
*c Montagerichtung
 mounting direction
 direction de montage

*d Einbauöffnung
 port
 ouverture d'emplacement

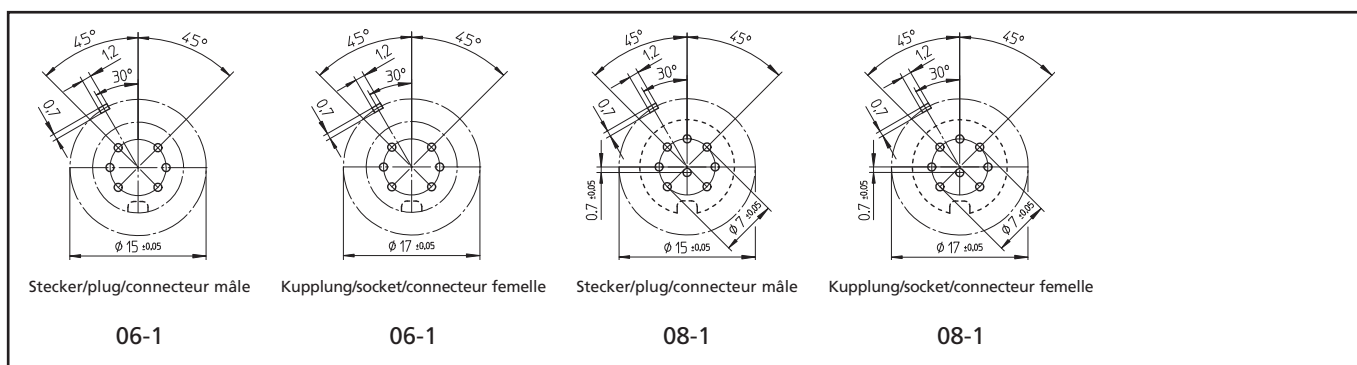


KFR KGR		KFR KGR	
Chassis socket acc. to IEC 60130-9, IP 40, with threaded joint, for printed circuit boards KFR: for front mounting KGR: for rear mounting		Embase femelle suivant CEI 60130-9, IP 40, avec verrouillage à vis, pour cartes imprimées KFR: pour montage de front KGR: pour montage par derrière	
1. Temperature range	-40 °C/+85 °C	1. Température d'utilisation	-40 °C/+85 °C
2. Materials		2. Matériaux	
Insulating body	PA GF	Corps isolant	PA GF
Contact bush 3 to 8 poles	CuZn, silvered and flash gilded, tinned in solder area	Prise de contact 3 à 8 pôles	CuZn, argenté et doré flash, étamé à la partie à souder
Contact bush 12 poles	CuZn, pre-nickeled and gilded, tinned in solder area	Prise de contact 12 pôles	CuZn, sous-nickelé et doré, étamé à la partie à souder
Housing	Zn diecast, nickeled	Boîtier	Zn moulé sous pression, nickelé
Ring nut	CuZn, nickeled	Écrou à anneau	CuZn, nickelé
3. Mechanical data		3. Caractéristiques mécaniques	
Insertion force/contact 3–8 poles ¹	< 5,0 N	Force d'insertion/contact 3–8 pôles ¹	< 5,0 N
Insertion force/contact 12 poles ²	< 5,0 N	Force d'insertion/contact 12 pôles ²	< 5,0 N
Withdrawal force/contact 3–8 poles ¹	> 1,2 N	Force de séparation/contact 3–8 pôles ¹	> 1,2 N
Withdrawal force/contact 12 poles ²	> 0,9 N	Force de séparation/contact 12 pôles ²	> 0,9 N
Mating with Protection ³	plugs 033098, 033099, SV, WSV IP 40	Raccordement avec connecteurs mâles 033098, 033099, SV, WSV IP 40	
4. Electrical data		4. Caractéristiques électriques	
Contact resistance	≤ 5 mΩ	Résistance de contact	≤ 5 mΩ
For further information see table		Pour plus de détails, voir tableau	
¹ measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm		¹ mesurée avec une tige d'acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm	
² measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.0 mm		² mesurée avec une tige d'acier poli, épaisseur nominale 1,0 mm	
³ according to DIN EN 60529, only in locked position with a proper counterpart		³ suivant DIN EN 60529, uniquement à l'état verrouillé avec un propre pendant	
⁴ according to VDE 0110/IEC 60664		⁴ suivant VDE 0110/CEI 60664	

Bestellbezeichnung Designation Désignation		Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit (VE) Package unit (PU) Unité d'emballage (UE)	Anschlussquerschnitt Wire section Section de racc. de fil	Bemessungsstrom Rated current Courant assigné	Bemessungsspannung ² Rated voltage ² Tension assignée ²	Prüfspannung Test voltage Tension d'essai	Isolationswiderstand Insulation resistance Résistance d'isolement	Kontaktkapazität Contact capacitance Capacité de contact
				mm ²	A	V AC	kV AC eff.	Ω	pF
KFR 30	KGR 30	3	50	0,75	5	250	2	10 ¹³	~ 2
KFR 40	KGR 40	4	50	0,75	5	250	2	10 ¹³	~ 2
KFR 50	KGR 50	5	50	0,75	5	60	1	10 ¹²	~ 3
KFR 50/6	KGR 50/6	5	50	0,75	5	250	2	10 ¹³	~ 2
KFR 60	KGR 60	6	50	0,75	5	250	2	10 ¹³	~ 2
KFR 70	KGR 70	7	50	0,75	5	250	2	10 ¹³	~ 2
KFR 71	KGR 71	7	50	0,75	5	60	1	10 ¹²	~ 3
KFR 80	KGR 80	8	50	0,75	5	60	1	10 ¹²	~ 3
KFR 81	KGR 81	8	50	0,75	5	60	1	10 ¹²	~ 3
KFR 120	KGR 120	12	50	0,25	3	60	1	10 ¹²	~ 3



Leiterplattenlayouts für Einbausteckverbinder, von der Bestückungsseite gesehen
Printed circuit board layouts for chassis connectors, components side view
Modèles de cartes imprimées pour embases, vus du côté à équiper



Leiterplattenlayouts für Einbausteckverbinder mit Massekontakt, von der Bestückungsseite gesehen
Printed circuit board layouts for chassis connectors with ground contact, components side view
Modèles de cartes imprimées pour embases avec contact de masse, vus du côté à équiper